

アテムコ社の導電性耐熱有機接着剤

# アテムコボンド 556-HT-SP

アテムコ社が開発した「アテムコボンド 556-HT-SP」はスクリーンプリント用に開発された、銀の粒子を充填したエポキシ系の導電性耐熱接着剤です。マイクロチップの接合や半導体のダイ接着、その他の電気電子部品の組み立てに活用されています。耐熱上限は230℃です。

## 特性

「アテムコボンド 556-HT-SP」は高純度の銀粒子を含有したベース樹脂と硬化剤を混合して使用する2液型です。体積抵抗率は常温で0.0004 ohm-cm、熱伝導性は3.5W/m-°K、引張せん断強度は1,400 psiです。

## 使い方

はじめに接着またはコーティングする面を十分に脱脂洗浄してください。  
次に樹脂ベースBと硬化剤Aを重量比1:1でよく混ぜ合わせます。  
ポットライフは約48時間です。  
被着体に薄く塗り、貼り合わせ、177℃で1時間、または、149℃で2時間焼成して硬化させます。  
硬化後の硬度はショアーDで88です。

## 荷姿

50グラム広口プラスチック容器入り。  
(ベース液と硬化剤の総量。)

